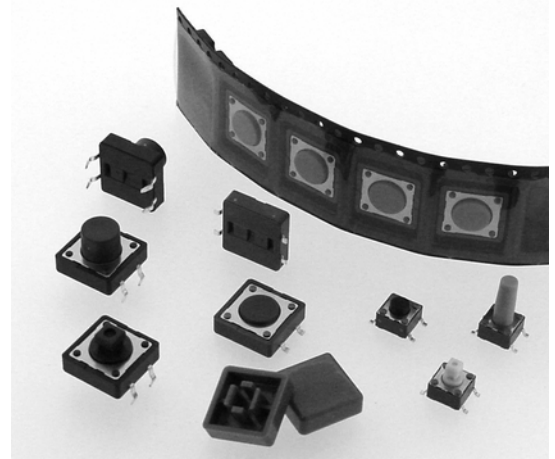


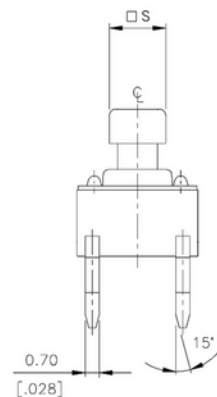
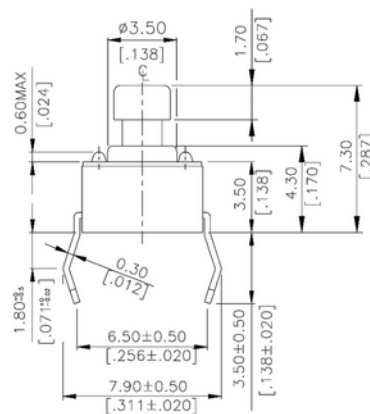
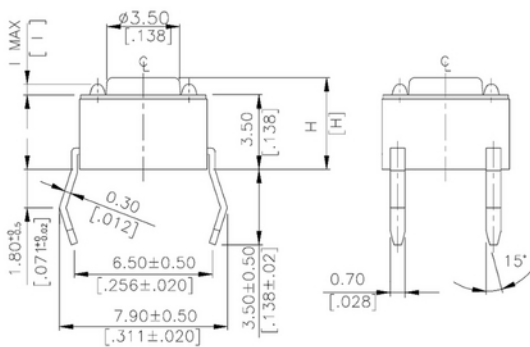
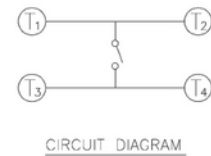
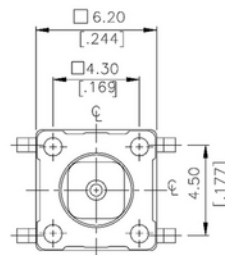
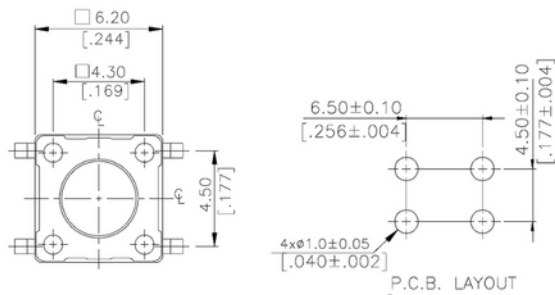
Taster & Kappen, Einlöt / SMT, Baugrößen 6x6 / 12x12mm Tact Switches & Caps, THT / SMT, 6x6 / 12x12mm Size

Technische Daten / Technical Data

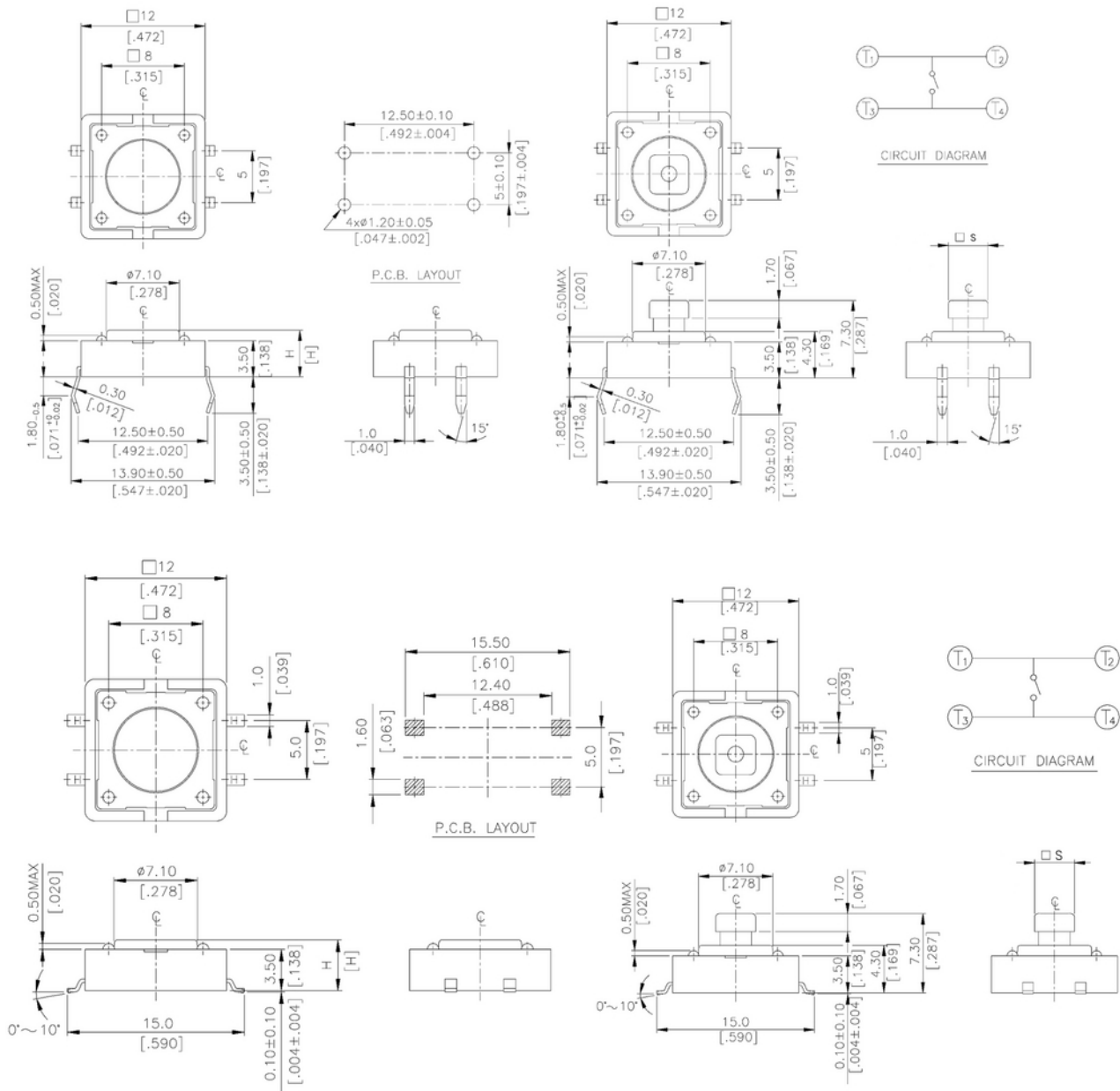
Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 Rostfreier Stahl
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0 Stainless Steel
Kontaktmaterial	Kupferlegierung, versilbert
Contact Material	Silver plated copper alloy
Kontaktbelastbarkeit	50mA, 12V _{DC}
Contact Rating	50mA, 12V _{DC}
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 100mΩ
Contact Resistance	< 100mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁸ Ω
Spannungsfestigkeit	250V _{AC}
Test Voltage	250V _{AC}
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Temperature Range	-25°C ... +70°C
Elektrische Lebensdauer	6x6: > 300 000 Schaltvorgänge 12x12: > 100 000 Schaltvorgänge
Electrical Life	6x6 > 300 000 operations 12x12: > 100 000 operations
Verarbeitung	Einlöt-Versionen: Wellenlötverfahren
Processing	SMT-Versionen: Kurzes Reflow-Lötverfahren
	Solder-In versions: Wave soldering
	SMT versions: Fast Profile Reflow-soldering
Max. Tasterbelastung	3kg vertikal für 15s
Max. Switching Force	3kg vertically for 15s



© W+P PRODUCTS



Hub / Stroke 0.25mm +0.20/-0.10



Hub / Stroke 0.35mm +/-0.10

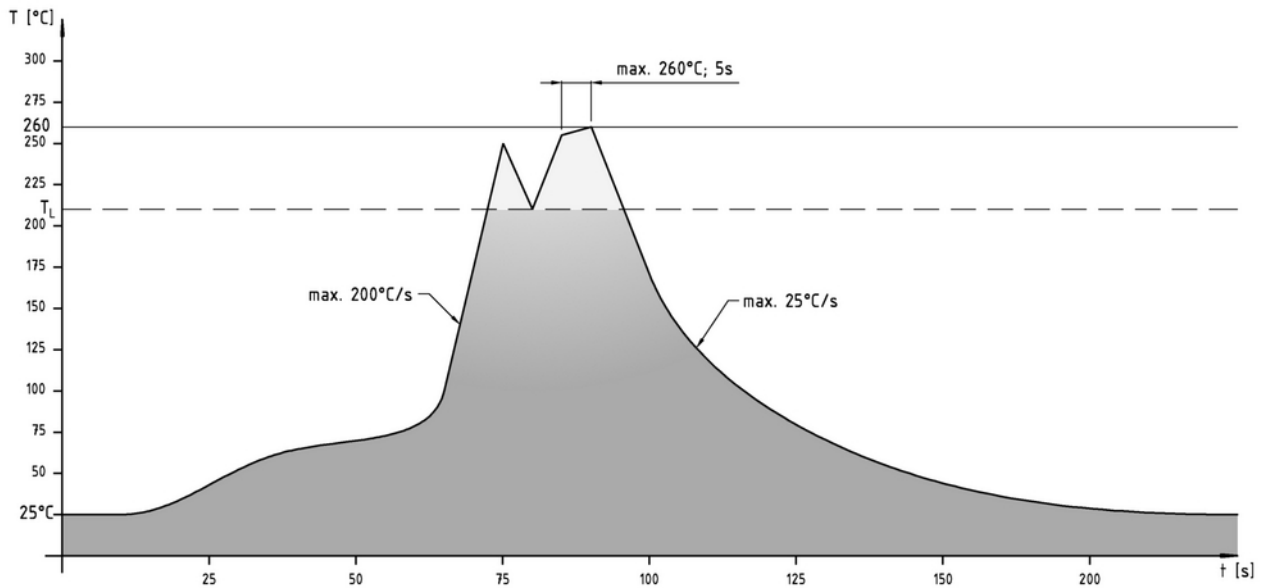
Series	Type*	Dimensions	Height*	Operating Force*	Package*
505	1 1 Einlöt Solder 2 SMT	2 2 12x12	5 1 H=4,30 5 H=8,50 93 H=7,30 S=3,80	30 30 160g±50 (braun) 160g±50 (brown) 40 260g±50 (rot) 260g±50 (red) 50 320g±80 (lachsfarben) 320g±80 (salmon)	00 00 Schüttgut (500 Stück/Beutel) Bulk goods (500pieces/bag) ST In Stangen (für SMT) In tubes (for SMT) TR Tape & Reel (für SMT bis Höhe 9,5mm) Tape & Reel (for SMT with max. height 9.5mm)

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Löttempfehlung für kurze Lötzeiten

Reflow Soldering Recommendation for shorter peak times

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
<i>Minimum Temperature T_{Smin}</i>	<i>150°C</i>
<i>Maximum Temperatur T_{Smax}</i>	<i>200°C</i>
<i>Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$</i>	<i>120-150s</i>
<i>Soldering Range Temperature T_L</i>	<i>230°C</i>
<i>Duration above T_L</i>	<i>60s max.</i>
<i>Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$</i>	<i>max. 1.5°C / s</i>
<i>Peak Temperature T_P</i>	<i>260°C max.</i>
<i>Duration Peak Temperature</i>	<i>5-10s</i>
<i>Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$</i>	<i>3°C / s</i>
<i>Duration 25°C - Peak Temp. T_P</i>	<i>Max. 4.5min</i>